

Sächsischer Arbeitskreis **VDE / VDI** Elektronik-Technologie

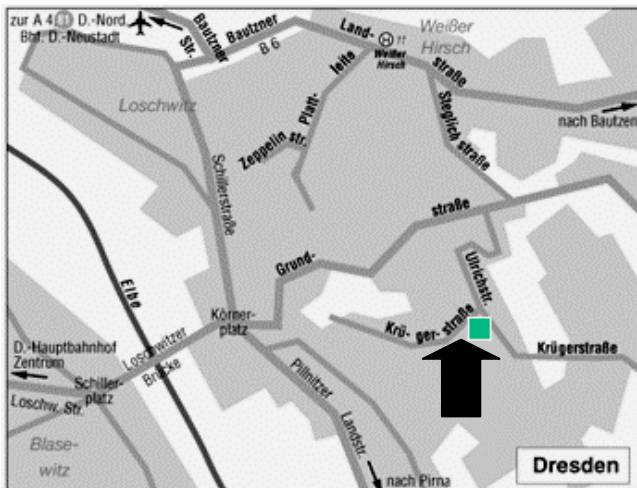
23. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie (VDE/VDI)

am **Donnerstag, 16. März 2000** **10.00 Uhr**
beim **Fraunhofer Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren EADQ,**
Krügerstr. 22, 01326 Dresden

Thema: Zerstörungsfreie Prüfung elektronischer Baugruppen und Werkstoffcharakterisierung

Leitung: Herr Dr. Baumbach, IZFP EADQ, Herr Prof. Sauer, TU Dresden

- 10:00 Uhr Zerstörungsfreie Prüfverfahren – Das Methodenpotential des IZFP
Herr Dr. Baumbach, IZFP EADQ
- 10:25 Uhr Neue Inspektionsmöglichkeiten mit Röntgenverfahren
Herr Dr. Baumbach, IZFP EADQ
- 10:50 Uhr Pause
- 11:10 Uhr Messung mechanischer Eigenspannungen in Schichten
Herr Prof. Schreiber, IZFP EADQ
- 11:35 Uhr Sensoren und Signalverarbeitung für zerstörungsfreie Prüfungen
Herr Dr. Hönig, Herr Dr. Hentschel, IZFP EADQ
- 12:00 Uhr Mittagspause (individuelles Mittagessen in der Gaststätte "Zur Eule" (ca. 10 min Fußweg))
- 13:15 Uhr Ultraschall- und Röntgenmikroskopie zur Qualitätsbewertung in der Baugruppenteknologie
Herr Dr. Herenz, Herr Dipl.-Ing. Daniel, Herr Prof. Wolter, TU Dresden
- 13:40 Uhr Intelligente Kameras in der Elektronikproduktion
Herr Dr. Kaiser, Dr. Kaiser Vision + Software GmbH, Dresden
- 14:05 Uhr Praktische Erfahrungen zur zerstörungsfreien Prüfung in der Flachbaugruppenfertigung
Herr Dipl.-Ing. Zschiedrich, Prettl Elektronik Radeberg GmbH
- 14:30 Uhr EU-Förderung für Forschung und technologische Entwicklung
Herr Dipl.-Math. Rehm, BTI mbH Dresden
- 14:55 Uhr aktuelle Informationen
- 15:15 Uhr Laborbesichtigung (Rasterkraftmikroskop, Feinstrahlionenanlage, Wärmewellenmikroskop,
Scanmaster, Laservibrometer, Akustische Signaturanalyse)



Lageplan für die Anfahrt
Fraunhofer Institut für Zerstörungsfreie
Prüfverfahren EADQ

Teilnahmemeldungen sind bis eine Woche vor der
Veranstaltung an Herrn Dr. R. Bauer, TU Dresden,
Institut für Elektronik-Technologie erbeten
(Fax.-Nr.: 0351/ 463 7069 oder
e-mail: r.bauer@iet.et.tu-dresden.de).
Aktuelle Informationen sind auch im Internet zu
finden unter
<http://www.et.tu-dresden.de/iet/iet.html>.

Laborbesichtigung

Rasterkraftmikroskop: Oberflächenabbildung mit atomarer Auflösung

Feinstrahlionenanlage: Waferfeinbearbeitung und -untersuchung

Wärmewellenmikroskop: Defektnachweis durch IR-Absorption

Scanmaster: Automatisierte Ultraschallprüfung

Laservibrometer: Berührungslose Schwingungsmessung

Akustische Signaturanalyse: Automatische Produktprüfung